

あらゆるアプリケーションに対応する SCREENの先進パターニング技術

Advanced Patterning Technology Suitable for Any Application

拝啓 時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

私どもSCREENは、ネプコンジャパン2018の「半導体・センサ パッケージング技術展」に出展いたします。「SCREEN Advanced Patterning Technology」をコンセプトに、直接描画・塗布など、SCREENが長年培ってきたさまざまな技術で、あらゆるアプリケーションのパターニング工程に幅広く対応する最新の装置を詳しくご紹介します。

この機会にぜひ弊社ブースにお越しいただき、最先端のテクノロジーをご実感ください。

何卒よろしく願いたします。 敬具

We are pleased to announce that SCREEN will be participating in the IC & Sensor Packaging Technology EXPO at NEPCON JAPAN 2018.

Focusing on the theme of "SCREEN's Advanced Patterning Technology," the exhibit will feature the latest systems for performing a wide range of patterning processes suitable for any application, including direct imaging, coating, and other proven SCREEN technologies.

We hope that you will take this opportunity to visit our booth and see these state-of-the-art technologies.

SCREEN
**Advanced Patterning
Technology**

第47回 **ネプコン ジャパン 2018**
47th NEPCON JAPAN

第19回 **半導体・センサ パッケージング技術展**
19th IC & Sensor Packaging Technology EXPO

[会期] 2018年1月17日(水)~19日(金)
10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

Dates & Times: Jan. 17 (Wed.) to 19 (Fri.), 2018
10:00 a.m. to 6:00 p.m. (last day until 5:00 p.m.)

[会場] 東京ビッグサイト [ブース] 東3ホール E25-12
Place: Tokyo Big Sight Booth: No. E25-12, East Hall 3

出展内容のご案内 Exhibited Products

アドバンスドパッケージ Advanced packaging

FOPLP用直接描画装置
Direct imaging system
for fan-out panel level packaging

DW-6000 **NEW**

優れた生産性と高解像度露光を両立した
FOPLP用直接描画露光装置

A direct imaging system for fan-out panel level packaging
that delivers superb productivity and high-resolution exposure



Direct
Imaging

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

アドバンスドパッケージ Advanced packaging

FOWLP用直接描画装置
Direct imaging system
for fan-out wafer level packaging

DW-3000

3次元実装、 bumps、ピラー形成に最適
Ideal for 3D packaging as well as bump and
pillar formation



Direct
Imaging

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.

高密度プリント配線板 High-density PCBs

直接描画装置
Direct imaging system

Ledia 6

フォトマスクを使用せず、
さまざまな感光材料を高速・高精度に露光。
High-speed, high-precision exposure of all types of
photosensitive material without using a photomask



Direct
Imaging

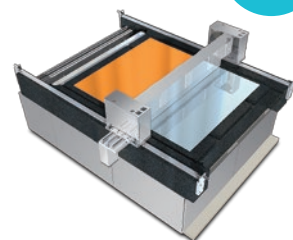
SCREEN PE Solutions Co., Ltd.

アドバンスドパッケージ Advanced packaging

パネルレベルスリットコーター
Slit coater for panel level packaging

LC-M550G

世界シェアNo.1スリット式塗布装置を
「パネルレベルパッケージ」向けに展開。
The world's best-selling slit coater
can now handle panel level packaging.



Coating

SCREEN Finetech Solutions Co., Ltd.

同時開催の展示会「オートモーティブ ワールド 2018」では、当社の冷間鍛造部品自動外観検査装置 IM-5100、熱間鍛造部品自動外観検査装置 IM-3200 を出展いたします。

SCREEN will also be exhibiting the IM-5100 automatic visual inspection system for cold forged parts and the IM-3200 automatic visual inspection system for hot forged parts at the concurrently held AUTOMOTIVE WORLD 2018.